



Brief zum Jahreswechsel 2016/17

Liebe IMAPS-Mitglieder,

die letzten Jahre waren geprägt von einem Generationswechsel in der Ingenieurwelt, der sich auch fachlich und methodisch in unserer Arbeit niederschlägt.

Leider ist es uns als Verein bisher noch nicht vollständig gelungen, diesen Generationswechsel in unserer Mitgliederstruktur nachzuvollziehen. Während die „Generation ISHM“ langsam in den Ruhestand geht, ist bei den Beitrittszahlen für Neumitglieder durchaus noch Luft nach oben. Für uns als Vorstand stand das Jahr 2016 daher ganz im Zeichen der angestrebten Verjüngung des Vereins und diesem Ziel haben wir uns gleich an mehreren Fronten gewidmet – nach innen und nach außen.

Wie es sich gehört, haben wir zunächst einmal vor der eigenen Haustür gekehrt und unseren Vorstand noch weiter verjüngt. Mit Dr. Dirk Siepe von der Hesse GmbH und Stefan Härter von Siemens werden zwei junge Kollegen frischen Wind in den erweiterten Vorstand bringen - wir werden Ihnen die beiden in einer der nächsten PLUS-Ausgaben ausführlicher im Interview vorstellen. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Ernst Eggelaar (Schatzmeister) und Dr. Markus Detert (2. Vorsitzender), denen ich für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren herzlich danken möchte. Unser Schriftführer Dirk Schade – seit September 2015 im Amt – zählt trotz langjähriger Erfahrung in der Industrie ebenfalls zur jüngeren Generation.



Stefan Härter



Dr. Dirk Siepe

Auch unsere Außendarstellung haben wir entstaubt. So gibt es neben dem neuen IMAPS-Flyer auch überarbeitete deutsche und europäische IMAPS Webseiten. Übersichtlicher, benutzerfreundlicher – und durch das neue Responsive Design sehen die Seiten auf dem Smartphone oder einem Tablet genauso gut aus wie am Rechner. Schauen Sie doch mal vorbei unter www.imaps.de oder www.imapseurope.org.



Im Zuge unserer „Verjüngungskampagne“ unterstützen wir außerdem das Projekt „Mikrochip ABC - Spannende Welt der Mikroelektronik“ (www.mikrochip-abc.de). Das Buch soll bei Schülern und Azubis das Interesse an der Mikroelektronik als möglichem Berufszweig wecken. Viele anschauliche Darstellungen und leicht verständliche Texte erklären die Themen so, dass auch Laien den Inhalt leicht begreifen. Als Dankeschön für die Förderung wurden uns einige Bücher zur Verfügung gestellt, die wir an Schulen und Bildungseinrichtungen verteilt haben. Auch die IMAPS-Mitglieder sollen davon profitieren und erhalten zum Jahresende ihr persönliches Exemplar dieses sehr gelungenen Buches.

Veranstaltungen

Mit unserer eigenen Herbstkonferenz und der IMAPS USA ist der Oktober immer ein ausgesprochener Reisemonat. In diesem Jahr fand die US-IMAPS vom 10.-13. Oktober in Pasadena statt. Dort wurde mir zu meiner großen Überraschung der IMAPS Fellow of the Society Award überreicht. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und sehe sie als Anerkennung der guten Arbeit des deutschen IMAPS-Chapters und als Ansporn für die kommenden Jahre.

Seit einiger Zeit bemühen wir uns, unsere eigenen Frühjahrsseminare an Universitäten oder Fachhochschulen durchzuführen, um so auch Studenten und Studentinnen die Teilnahme zu ermöglichen. In diesem Jahr fand das Seminar am 14. April am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS) der Friedrich-Alexander-



Brief zum Jahreswechsel 2016/17



Universität Erlangen-Nürnberg statt. Neben einem hochwertigen Vortragsprogramm und der Ausstellung hatten die ca. 50 Teilnehmer auch die Möglichkeit, die umfangreichen Laborausrüstungen der FAPS zu besichtigen. Die diesjährige Herbsttagung fand wie üblich an der HS in München mit rund 80 Teilnehmern und 12 Ausstellern statt. Einen ausführlichen Bericht zu dieser Veranstaltung finden Sie in der Dezemberausgabe der PLUS.



Was wird das nächste Jahr bringen?

Veranstaltungstechnisch beginnt das neue Jahr für uns mit dem eintägigen Frühjahrsseminar zum Thema Sensorik „Package: Der Schlüssel zum optimalen Sensor?!?“ Bitte markieren Sie sich den 23.03.2017 schon mal im Kalender, nähere Informationen zum Ort und zum Programm gibt es dann Anfang des Jahres.

Erstmalig kooperieren wir 2017 mit der SMT Hybrid Packaging Konferenz und Messe. Von allen europäischen Messen ist die SMT diejenige, die uns thematisch am engsten verbunden ist. Für Sie als IMAPS-Mitglieder bedeutet die Kooperation kostenlosen Eintritt zur Messe und 15% Rabatt auf Kongress, Tutorials und Workshops und ich würde mich freuen, viele von Ihnen auf der SMT zu treffen!

Ein Highlight im kommenden Jahr wird ganz sicher die EMPC 2017 im September in Warschau sein und als General Chair der letzten EMPC von 2015 wird es mir ein ganz besonderes Vergnügen sein, die Vorbereitungen dieses Mal von der Seitenauslinie zu beobachten und einfach als Gast und Session Chair im September nach Warschau zu reisen. Genauer zum Call for Paper und zur begleitenden Fachmesse finden Sie unter www.empc2017.pl.

Abschließend möchte ich mich bei allen Vereinsmitgliedern für Ihre Mitarbeit im vergangenen Jahr bedanken. Jeder Verein lebt von den Aktivitäten seiner Mitglieder und auch wir können nur deshalb so erfolgreich agieren, weil Sie uns als Referenten, Aussteller und Sponsoren unterstützen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich, auch im Namen meiner Vorstandskollegen, entspannte Feiertage sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für das kommende Jahr. Hoffen wir, dass 2017 politisch und gesellschaftlich etwas weniger turbulent und vor allem friedlicher sein wird als das vergangene Jahr.

Herzlichst,

Martin Schneider-Ramelow
1. Vorsitzender IMAPS-Deutschland